

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2017-064

北京君正集成电路股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月收到公司承担的《智能终端处理器芯片研发及先进封装技术导入》项目的部分补助资金 333.33 万元。该项目执行期为自收到该笔资金起至 2016 年底，项目于执行期结束后进行验收，通过政府项目验收后将拨发剩余补助资金。该笔补助资金的详细内容已于 2014 年 10 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。

目前该项目已通过验收，近日，根据验收结果公司收到了该项目的剩余补助资金 166.67 万元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，上述补助资金将一次性结转至当期损益。该笔补助资金预计将对公司 2017 年度利润产生一定影响。

该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日